

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2021年4月1日(01.04.2021)



(10) 国際公開番号

WO 2021/059843 A1

(51) 国際特許分類:
C08G 59/42 (2006.01) *G03F 7/004* (2006.01)
(21) 国際出願番号: PCT/JP2020/032296
(22) 国際出願日: 2020年8月27日(27.08.2020)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
特願 2019-172590 2019年9月24日(24.09.2019) JP

(71) 出願人: 東レ株式会社 (**TORAY INDUSTRIES, INC.**) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 松村 和行 (**MATSUMURA, Kazuyuki**); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 楯岡佳子 (**TATEOKA, Yoshiko**); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 嶋田彰 (**SHIMADA, Akira**); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) **Title:** RESIN COMPOSITION, RESIN COMPOSITION FILM, CURED FILM, HOLLOW STRUCTURE USING SAME, AND SEMICONDUCTOR DEVICE

(54) 発明の名称: 樹脂組成物、樹脂組成物フィルム、硬化膜、これらを用いた中空構造体、および半導体装置

(57) **Abstract:** In order to provide a resin composition and resin composition film of superior patternability and film strength, and a semiconductor device using the same, the present invention provides a resin composition containing (A) a polymer compound, (B) a cation-polymerizable compound, and (C) a cation polymerization initiator, the composition being characterized in that the molecular chain of the polymer compound (A) has carboxylic acid residue at the end thereof.

(57) 要約: パターン加工性、膜強度に優れた樹脂組成物、樹脂組成物フィルムおよびこれらを用いた半導体装置を提供するため、(A) 高分子化合物、(B) カチオン重合性化合物、および(C) カチオン重合開始剤を含有する樹脂組成物であって、前記(A) 高分子化合物は、その分子鎖末端がカルボン酸残基であることを特徴とする、樹脂組成物、とする。



WO 2021/059843 A1